

御中

No.PCN-SM2301

2023 年 4 月 14 日

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社

品質保証部

部 長 渡 辺 達 啓



製品納入時の包装仕様の追加について（通知）

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、現在貴社にご採用いただいております製品につきまして、
納入時に使用する包装材の仕様を追加させていただきます。
変更内容は下記の通りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

敬 具

- 記 -

1. 対象製品

- ・ Tray 包装形態で納入している製品

対象製品リスト.xlsxのシート：対象製品リスト Tray 2 (TFME)

- ・ Tube 包装形態で納入している製品

対象製品リスト.xlsxのシート：対象製品リスト Tube 2 (TFME)

- ・ Emboss 包装形態で納入している製品

対象製品リスト.xlsxのシート：対象製品リスト Emboss 2 (TFME))

2. 追加内容

- ・ 内装箱において、印字デザインなし仕様を追加します。
 - ・ 外装箱において、印字デザインなし仕様を追加します。
- なお、変化点は印字デザインだけであり、材料・設計など基本仕様に変更はございません。

3. 追加理由

現行の包装仕様は対象製品の専用仕様となっています。
この専用仕様による対応は、市況の影響を受けやすく、安定した包装部材の調達が難しくなっているため、安定した製品納入を継続できるよう、汎用として使用している包装仕様も使用した「現行仕様と追加仕様」の併用による納入とさせていただきます。

4. 追加予定時期

2023年 10月1日以降の納入より適用させていただきます。

5. 追加する包装仕様

追加仕様については、6項にあります現行仕様と追加仕様内容を参照願います。
なお、仕様追加による製品の品質、保証に変更はございません。

6．現行仕様と追加仕様内容

・Tray 包装形態で納入している製品 [対象製品リスト Tray 2 (TFME)]

形態	内装箱		外装箱（国内出荷）		外装箱（国外出荷）	備考
Tray						・内装箱 デザインなしを追加 ・外装箱 仕様追加なし
	現行	デザインなし仕様追加	現行	追加なし	現行	

・Tube 包装形態で納入している製品 [対象製品リスト Tube 2 (TFME)]

形態	内装箱		外装箱（国内出荷）		外装箱（国外出荷）	備考
Tube						・内装箱 デザインなしを追加 ・外装箱(国内) デザインなしを追加 ・外装箱(海外) 仕様追加なし
	現行	デザインなし仕様追加	現行	デザインなし仕様追加	現行	

・Emboss 包装形態で納入している製品 [対象製品リスト Emboss 2 (TFME)]

形態	内装箱		外装箱（国内出荷）		外装箱（国外出荷）	備考
Emboss tape						・内装箱 デザインなしを追加 ・外装箱 仕様追加なし
	現行	デザインなし仕様追加	現行	追加なし	現行	

<連絡先>

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社
 営業統括部 第一営業部
 部長 野呂 幸一
 Email : noro.kouichi@fujitsu.com

以上